

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 103 40 333.7

Anmeldetag: 29. August 2003

Anmelder/Inhaber: Infineon Technologies AG, 81669 München/DE

Bezeichnung: Carrier zur Aufnahme und zur elektrischen
Kontaktierung von vereinzelten Dies

Priorität: 10.01.2003 DE 103 00 817.9

IPC: H 01 L 23/50

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 16. Januar 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Klostermeyer



5 **Carrier zur Aufnahme und zur elektrischen Kontaktierung von vereinzelten Dies**

Die Erfindung betrifft einen Carrier zur Aufnahme und elektrischen Kontaktierung von vereinzelten Dies (Nacktchips) zum Testen und/oder zum BurnIn derselben, wobei der Carrier erste Kontakte aufweist, die in einem dem zu kontaktierenden Die entsprechenden Raster angeordnet sind.

Üblicherweise werden Dies nach dem Back End Prozess, also der vollständigen Montage auf einem Trägerelement (PCB) einem Funktionstest unterzogen, dem sich ein BurnIn (Voralters) anschließen kann. Bei der neueren Entwicklung von Bauelementen mit mehrfach gestapelten Dies lässt sich der Test und das BurnIn nach der vollständigen Montage grundsätzlich auf die gleiche Weise durchführen, wie bei den Bauelementen mit nur einem Die. Wenn hier allerdings defekte Dies verbaut worden sind, wäre hier die Folge, dass dann das gesamte Bauelement verworfen wird, da eine Reparatur praktisch ausgeschlossen ist. Das ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar.

Aus dieser Situation ergibt sich die Notwendigkeit, die Dies vor dem Stapeln auf einer PCB einzeln zu testen und gegebenenfalls einem BurnIn zu unterziehen.

Um dies mit möglichst geringen Kosten realisieren zu können, sollten vorhandene Ausrüstungen für Test- und BurnIn-Zwecke verwendet werden. Die bekannten Klemm- und Befestigungsvorrichtungen sind allerdings für die Kontaktierung von Aluminium-Kontakten (Pads) ungeeignet.

Das Hauptproblem ist dabei der geringe Abstand der Bond-Pads

zueinander (Bond-Pad-Pitch). Der Grund dafür liegt in dem Erfordernis der besonders präzisen Positionierung des Dies, welche außerdem bis zu dessen vollständiger Kontaktierung sicher gestellt werden muss. Üblicherweise erfolgt die Befestigung eines Dies auf einem Carrier durch mechanischen Andruck mittels eines geeigneten Deckels, der den Die mit hinreichender Kraft in den Carrier drückt. Dabei besteht die Gefahr einer Relativbewegung zwischen Die und Carrier. Diese Relativbewegung kann erst bei einem elektrischen Test sicher festgestellt werden.

10. Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, einen Carrier anzugeben, mit dem vereinzelte Dies genau mechanisch und elektrisch kontaktierbar sind, um deren Funktionsprüfung und Voralterung mit dem vorhandenen Equipment insbesondere zur Realisierung des „Known-Good-Die-Konzepts“ durchführen zu können.

15. Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass die ersten Kontakte des Carriers mit Elastomer-Bumps versehen sind, welche zweite Kontakte auf der Spitze aufweisen, die mit den ersten Kontakten elektrisch verbunden sind und dass die Dies mit einer durch ein Vakuum erzeugten, vorgegebenen Kraft gegen die Elastomer-Bumps gezogen werden.

Indem der einzelne Die nach seiner genauen Positionierung im Carrier durch das Vakuum in genau dieser Lage fixiert wird, ist diese hohe Positioniergenauigkeit sowohl bei der Befestigung als auch beim Halten des Dies während Transport und Messung möglich. Mit der Fixierung des Dies durch die mit dem Vakuum erzeugte Ansaugkraft wird eine Relativbewegung zwischen Carrier und Die, die der Fixierung dient, vermieden. Spätere Bewegungen oder Erschütterungen haben auf die Positionierung keinen Einfluß mehr, solange die dabei auftretenden Kräfte kleiner sind als die Ansaugkraft des Vakuums, wobei diese selbst auch regelbar ist.

Die Möglichkeit der genaueren Positionierung bringt es im Übrigen

gen auch mit sich, dass Pads mit noch kleineren Abständen im erfindungsgemäßen Carrier kontaktierbar sind.

Durch permanente Vakuumansaugung und flächigen mechanischen An- druckkontakt wird gleichzeitig der Ausgleich einer möglichen 5 Verwölbung und von Höhenunterschieden im Kontaktssystem er- reicht.

Erfindungsgemäß wird der Die durch die Vakuumansaugung gegen Elastomer-Bumps gezogen, die in der Lage sind, Höhenunterschie- 10 de im Kontaktssystem auszugleichen sowie eventuell auch auftre- tende Querspannungen bis zu einer gewissen Größe aufzunehmen, so dass sie Voraussetzung sind für eine zuverlässige Kontaktie- rung aller Kontakte des Dies.

Diesem Ziel werden weitere Gestaltungen des erfindungsgemäßen 15 Carriers gerecht, welche vorsehen, dass die zweiten Kontakte an der Spitze der Elastomer-Bumps Goldkontakte sind und/oder dass die elektrische Verbindung der ersten mit den zweiten Kontaktén durch auf den Elastomer-Bumps spiral- oder bogenförmig zur Spitze aufsteigende Leiterbahnen hergestellt ist.

Während durch die Goldkontakte eine besonders gute elektrische 20 Verbindung zu den Kontakten des Dies infolge der Verringerung des Übergangswiderstandes realisiert wird, ist eine spiral- oder bogenförmige Leiterbahn, welche sich gewissermaßen auf dem Elastomer-Bump bis zu dessen Spitze windet, in der Lage ein Zu- 25 sammendrücken des Elastomer-Bumps oder auch geringe seitliche Verschiebungen auszugleichen ohne zu reißen.

Wenn derartige aufsteigende Leiterbahnen darüber hinaus einen 30 Kupfer-Nickel-Gold-Schichtaufbau aufweisen, werden die darge- stellten Vorteile mit den bekannten eines solchen Schichtauf- baus, welche einen guten und zuverlässigen Kontakt realisieren, verknüpft.

Eine weitere Verbesserung des Kontaktes wird in einer anderen Ausgestaltung der Erfindung erzielt, indem zwischen dem Die und dem Carrier ein Gold-Gold-Kontakt realisiert ist, da damit der Übergangswiderstand weiter verringert werden kann. Dies wird dadurch erreicht, dass auf dem Die Umverdrahtungsebenen (Re-Distribution-Layer) angeordnet sind, welche die Aluminium-Kontakte des Dies zu Gold-Kontakten umverdrahten, so dass die Gold-Kontakte an der Spitze der Elastomer-Bumps mit den umverdrahteten Gold-Kontakten des Dies kontaktiert sind. Dafür ist es jedoch auch erforderlich, dass die Re-Distribution-Layer die guten elektrischen Eigenschaften eines Kupfer-Nickel-Gold-Schichtaufbau aufweisen.

Des Weiteren ist es durch die Verwendung eines Re-Distribution-Layers möglich, Pads mit sehr kleinen Abständen im Carrier zu kontaktieren, da mittels des Re-Distribution-Layers diese Kontakte gewissermaßen auseinander gezogen werden können, soweit es die Größe des Dies ermöglicht.

Da nach der anfänglichen mechanischen und elektrischen Kontaktierung des Dies im Verlauf der Funktionsprüfung und der Voralterung ein vielfältiges Handling erforderlich sein kann, sieht eine weitere erfindungsgemäße Gestaltung eines Carriers vor, dass der Die bis zur endgültigen Montage im Carrier fixiert und so das Erfordernis weiterer Kontaktierungen vermieden wird.

Eine in diesem Sinne besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass die Fixierung des Dies durch einen Deckel erfolgt, der die Elastomer-Bumps nach der Montage mit einer vorgegebenen Andruckkraft zusammendrückt. Da, wie beschrieben, die genaue Position des Dies im Carrier durch dessen Vakuumansaugung gehalten wird, hat die nachträglich vorgenommene zusätzliche Fixierung durch einen eventuell auch Relativbewegungen ausführenden Deckel keinen Einfluss auf die Position des Dies.

Die zusätzliche Fixierung des Dies auf diese Weise hat mehrere Vorteile. Zum einen kann ein derart fixiertes Die nahezu nicht ungewollt verschoben und somit dessen Prüfung gestört werden, da solch ein bekannter Deckel, wie eingangs beschrieben eine hohe Andruckkraft auf den Die ausübt und diesen gleichzeitig vor äußerer mechanischer Beeinflussung abschirmt.

Zum zweiten kann nach dieser mechanischen Fixierung auf die Vakuumansaugung verzichtet werden, was zum Beispiel für den Transport des Carriers erforderlich ist.

Zum dritten kann mit der anfänglichen Ansaugung und nachträglichen mechanischen Fixierung der Die in das vorhandene Handling eingefügt, so dass für die Prüfung des Einzeldies das Equipment nutzbar ist, welches zur Prüfung des konventionell montierten Dies bereits vorhanden ist. Darüber hinaus sind auch für die Herstellung des Carriers selbst die gut bekannten, genauen und zuverlässigen Verfahren anwendbar.

Aufgrund der erfindungsgemäßen Verwendung von Elastomer-Bumps und deren Fähigkeit, geringfügige laterale und normale Verschiebungen ohne Abriss des Kontaktes auszugleichen, ist es möglich, die Andruckkraft, die ein Deckel auf die Elastomer-Bumps ausübt, von bisher ungefähr 20 Gramm auf ungefähr 2 bis 8 Gramm, vorzugsweise 5 Gramm pro Elastomer-Bump zu verringern. Diese Verringerung vereinfacht in erheblichem Maße das Handling beim Öffnen und Schließen des Deckels und reduziert weiterhin den mechanischen Stress auf den Die.

Insbesondere, jedoch nicht notwendigerweise, ermöglicht es diese Verringerung der Andruckkraft, dass der Deckel als Federelement ausgebildet ist, was ebenfalls den Rückgriff auf ein bewährtes Element eines Carriers mit gutem Handling ermöglicht.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von zwei Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die Zeichnungsfiguren zeigen:

Fig. 1 a: die schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Carriers in der Draufsicht;

Fig. 1 b: die schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Carriers in der Seitenansicht;

5 Fig. 1 c: die schematische Schnittdarstellung eines erfindungsgemäßen Carriers, entlang der Achse A geschnitten;

10 Fig. 1 d: die schematische Schnittdarstellung eines erfindungsgemäßen Carriers, entlang der Achse B geschnitten;

Fig. 1 e, f: die schematischen Schnittdarstellungen zweier Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Carriers, entlang der Achse A geschnitten;

15 Fig. 1 g: die schematische Schnittdarstellung der Ausführungsform entsprechend Fig. 1 f des erfindungsgemäßen Carriers, entlang der Achse B geschnitten;

20 Fig. 2 a - d: schematische Darstellungen der Draufsicht, Seitenansicht und Schnittdarstellungen entsprechend den Fig. 1 a - d einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Carriers;

Fig. 2 e, f: eine schematische Schnittdarstellung des erfindungsgemäßen Carriers, entlang der Achse B geschnitten, mit zwei Ausführungsformen des Deckels;

25 Fig. 3 a, b: einen vergrößerten Ausschnitt des erfindungsgemäßen Carriers mit einem Teil eines Hilfswerkzeuges zum Be- und Entstücken, d.h. zum Lösen (Taper Pin Technologie) des Deckels (Snap-In-Mechanismus);

Fig. 4. einen vergrößerten, schematisch dargestellten Aus-
schnitt des erfindungsgemäßen Carriers mit einem E-
lastomer-Bump.

Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Car-
riers, im Wesentlichen bestehend aus einem Grundträger 1, einem
darauf befestigten Rahmen 2, Rahmenklammern 3 aufweisend, und
einem auf dem Rahmen 2 aufliegenden Deckel 4, Deckelklammern 5
aufweisend, und die Elastomer-Bumps 6. Der Rahmen 2 umschließt
eine Fläche auf dem Grundträger 1, welche der Fläche des aufzu-
nehmenden, vereinzelten Dies 7 entspricht oder nur geringfügig
größer ist. Innerhalb dieser Fläche sind die Elastomer-Bumps 6,
die der Kontaktierung des Dies 7 dienen, rasterartig entspre-
chend einem Ball-Grid-Array angeordnet.

Die Elastomer-Bumps 6 sind mittels auf dem Grundträger 1 vor-
handener strukturierter Metallisierung 8 mit Kontakt-Pads 9 e-
lektrisch verbunden, welche sich im Randbereich des Grundträ-
gers 1 befinden und der Kontaktierung zur Funktionsprüfung
und/oder Voralterung dienen. Auf den Elastomer-Bumps 6 und so-
mit innerhalb des Rahmens 2 ist der zu testende Die 7 Face-down
positioniert.

Die Positionierung des Dies 7 erfordert eine hohe Genauigkeit,
um das Raster der Bond-Pads 28 des Dies 7, welches mit sehr
dichtem Rastermaß vorliegen kann, mit dem Raster der Elastomer-
Bumps 6 in Übereinstimmung zu bringen. Zu diesem Zweck ist zum
einen die Größe des Rahmens 2 auf die Größe des Dies 7 abge-
stimmt und zum zweiten die zum Die 7 weisende Innenkante des
Rahmens 2 in Richtung Die abgeschrägt, so dass diese Schrägen 30
gewissermaßen als Führung bei der Positionierung des Dies 7
dienen kann.

Für die Positionierung selbst und ebenso für die Demontage des
Dies 7 ist ein sehr sensibles und präzises Werkzeug erforder-
lich, wie es insbesondere der Die-Bonder vorstellt. Ein nicht

dargestellter Die-Bonder nimmt einen zu testenden einzelnen Die 7 auf und führt und positioniert ihn innerhalb des Rahmens 2 auf den Elastomer-Bumps 6.

Unmittelbar nach der Positionierung des Dies 7 erfolgt dessen 5 zumindest vorübergehende Fixierung mittels Vakuumansaugung. Dafür weist der Grundträger 1 innerhalb des Rahmens 2 Öffnungen 10 auf, welche an ein nicht dargestelltes Vakuumansaugungssystem anschließbar sind. Infolge der Vakuumansaugung wird der Die 7 an die Elastomer-Bumps 6 gezogen und dort fixiert. Nachfolgend 10 wird der Deckel 4 mit den Deckelklammern 5 auf den Rahmenklammern 3 abgelegt und anschließend mit Kraft zusammengedrückt, wobei die Klammern 3, 5 gegeneinander lösbar einrasten und aufgrund ihrer Hakenform den Deckel 4 arretieren. In dieser Lage 15 liegt die Innenseite des Deckels 4 auf der Rückseite des Dies 7 auf und presst ihn gegen die Elastomer-Bumps 6. Während der mechanischen Fixierung durch den Deckel 4 kann die Vakuumansaugung unterbrochen werden. Die Fig. 1 a) bis 1 d) zeigen die verschiedenen Ansichts- und Schnittdarstellungen dieses Carriers.

20 Der in Fig. 1 e) dargestellte Carrier wird, bei sonst im Wesentlichen gleichen Aufbau, nicht durch seitliche, sondern durch auf der Unterseite des Grundträgers 1 befindliche Kontakt-Pads 9 mit einer Leiterplatte 11 unterhalb des Grundträgers 1 dadurch kontaktiert, dass diese Leiterplatte 11 zu den 25 Kontakt-Pads 9 korrespondierende, nicht dargestellte Kontakte aufweist und mittels eines darunter befindlichen Elastomerkissens 12 gegen den Grundträger 1 gepresst und somit der elektrische Kontakt hergestellt wird.

Die Vakuumansaugung erfolgt in dieser Ausführung ebenfalls 30 durch Öffnungen 10 im Grundträger 1, die sich jedoch auch in der Leiterplatte 11 und dem Elastomerkissen 12 fortsetzen.

In Fig. 1 f) ist durch eine geänderte Ausführung des Grundträ-

gers 1 ebenfalls die Kontaktierung des Carriers durch Kontakt-Pads 9 realisiert, die sich auf der Unterseite des Grundträgers 1 befinden.

In dieser Ausführungsform ist der Grundträger 1 zweischichtig ausgeführt. Die obere Schicht weist leitfähige erste Durchgänge 14 auf, durch welche die Elastomer-Bumps 6 mit einer metallischen Leitungsstruktur 15 verbunden sind, die sich auf der Oberseite der unteren Schicht 16 befindet und wiederum die ersten Durchgänge 14 mit leitfähigen zweiten Durchgängen 17 in der unteren Schicht 16 elektrisch kontaktiert.

Die zweiten Durchgänge 17 wiederum sind mit den auf der Unterseite der unteren Schicht 16 des Grundträgers 1 befindlichen Kontakt-Pads 9 elektrisch verbunden, indem beide miteinander korrespondieren. Die Vakuumansaugung erfolgt ebenfalls durch Öffnungen 10 im Grundträger 1, wobei die Öffnungen 10 durch die untere 16 und durch die obere Schicht 13 durchgehend vorhanden sind.

Fig. 1 g) stellt die Ausführungsform entsprechend der Fig. 1 f) in einer weiteren Schnittdarstellung dar, deren vertikale Schnittebene 90° gedreht zu der vertikalen Schnittebene der Fig. 1 f) liegt.

Die Fig. 2 a) bis d) stellen eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Carriers dar, die sich von der in Fig. 1 dargestellten dadurch unterscheidet, dass der Grundträger 1 lediglich die Größe des Rahmens 2 zuzüglich der Rahmenklammern 3 hat und die Kontaktierung des Carriers zur Funktionsprüfung des Dies 7 mittels auf der Unterseite des Grundträgers 1 rasterartig, flächig angeordneter Lotkugeln 18 (FBGA-ähnlich) erfolgt.

Die elektrische Verbindung zwischen den Elastomer-Bumps 6 und den Lotkugeln 18 erfolgt durch leitfähige, erste Durchgänge 14 und eine auf der Unterseite des Grundträgers 1 befindliche me-

tallische Leitungsstruktur 15.

In den Fig. 2 e) und f) sind mittels FGBA-ähnlicher Lotkugeln 18 kontaktierbare Carrier dargestellt. In Fig. 2 e) sind die Rahmenklammern 3 und Deckelklammern 5 an einer Seitenfläche des

5 Rahmens 2 und des Deckels 4 durch ein erstes Gelenk 19 ersetzt, so dass der Deckel 4 durch das erste 19, Gelenk fest mit dem Rahmen 2 verbunden und um die Achse dieses ersten Gelenks 19, welche parallel zu eben dieser Seitenkante des Rahmens 2 liegt, drehbar gelagert ist.

10 Die übrigen Rahmenklammern 3 an den übrigen drei Seiten des Rahmens 2 sind mittels zweiter Gelenke 20 drehbar ausgeführt, deren Drehachsen parallel zur Rahmenaußenkante und in einer Ebene liegen, die näherungsweise mit der dem Die 7 zugewandten Seite des Deckels 4 übereinstimmt.

15 Der Deckel 4 weist anstelle der Deckelklammern 5 eine spitzwinklige Kante 21 auf, über welche die Rahmenklammern 3 durch eine Drehbewegung um die Achse des zweiten Gelenks 20 greifen, um den Deckel 4 zu arretieren und die Arretierung durch eine gegenläufige Drehbewegung der Rahmenklammern 3 wieder lösbar

20 ist.

Auch Fig. 2 f) stellt eine Variante der Arretierung des Deckels 4 dar. In dieser Ausführung weisen Rahmen 2 und Deckel 4 keine Rahmenklammern 3 und Deckelklammern 5 auf. Anstelle dessen zeigt der Rahmen 2 innenseitig eine umlaufende Kehle 22, in welche eine umlaufende, den äußeren Rand des Deckels 4 bildende Wulst 23 passend eingreift.

25 Durch eine federartige Form des Deckels 4 übt die Wulst 23 des Deckels 4 im eingebauten Zustand eine nach außen wirkende Kraft auf den Rahmen 2 aus, welche die Arretierung des Deckels 4 bewirkt und zu überwinden ist, um den Deckel 4 zu lösen.

In Fig. 3 a) und b) sind zwei Phasen des Vorganges zum Lösen der Rahmenklammern 3 und Deckelklammern 5 (entsprechend Fig. 1) mit Hilfe eines Hilfswerkzeuges 24, welches die Form eines spitzwinkligen Kegelstumpfs mit abgerundeten Kanten hat. Das 5 Hilfswerkzeug 24 wird in den Zwischenraum geführt, welcher zwischen Rahmenklammer 3 und Deckel 4 besteht (a) und durch ein Drücken des kegelstumpfförmigen Hilfswerkzeugs 24 gegen die konisch geformte Innenseite der Rahmenklammer 3 wird diese nach außen bewegt und löst sich auf diese Weise von der Deckelklammer 5.

Fig. 4 stellt schematisch solch einen Ausschnitt des erfindungsgemäßen Carriers dar, in welchem ein Elastomer-Bump 6 ersichtlich ist. Der Grundträger 1 umfasst eine strukturierte Metallisierung 8, die im ohmschen Kontakt mit rasterartig, flächig angeordneten ersten Kontakts 25 stehen, welche wiederum 15 die Elastomer-Bumps 6 tragen.

Jedes Elastomer-Bump 6 weist auf seiner abgeflachten Spitze einen Gold-Kontakt als zweiten Kontakt 26 auf, welcher durch eine auf der Oberfläche des Elastomer-Bumps 6 spiral- oder bogenförmig aufsteigende Leiterbahn 27 mit dem ersten Kontakt 25 elektrisch verbunden ist und außerdem mit einem Bond-Pad 28 elektrisch verbunden ist, welches der Kontaktierung des Dies 7 dient. Der Die 7 weist zur elektrischen Verbindung des Bond-Pads 28 einen Re-Distribution-Layer 29 auf.

5 Carrier zur Aufnahme und zur elektrischen Kontaktierung von
vereinzelten Dies

Bezugszeichenliste

- 10 1 Grundträger
- 2 2 Rahmen
- 3 3 Rahmenklammer
- 4 4 Deckel
- 5 5 Deckelklammer
- 15 6 Elastomer-Bump
- 7 7 Die
- 8 8 strukturierte Metallisierung
- 9 9 Kontakt-Pad
- 10 10 Öffnung
- 20 11 Leiterplatte
- 12 12 Elastomerkissen
- 13 13 obere Schicht
- 14 14 erste Durchgänge
- 15 15 metallische Leitungsstruktur
- 25 16 untere Schicht
- 17 17 zweite Durchgänge
- 18 18 Lotkugeln
- 19 19 erstes Gelenk
- 20 20 zweites Gelenk
- 30 21 Kante
- 22 22 Kehle
- 23 23 Wulst
- 24 24 Hilfswerkzeug
- 25 25 erster Kontakt
- 35 26 zweiter Kontakt

AS

- 27 aufsteigende Leiterbahn
- 28 Bond-Pad
- 29 Re-Distribution-Layer
- 30 Schräge
- 5 31 konische Außenflächen
- 32 konische Innenflächen

5. Carrier zur Aufnahme und zur elektrischen Kontaktierung von vereinzelten Dies

Patentansprüche

10. 1. Carrier zur Aufnahme und elektrischen Kontaktierung von vereinzelten Dies (Nacktchip) zum Testen und/oder zum BurnIn derselben, wobei der Carrier erste Kontakte aufweist, die in einem dem zu kontaktierenden Die entsprechenden Raster angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Kontakte (25) mit Elastomer-Bumps (6) versehen sind, welche zweite Kontakte (26) auf der Spitze aufweisen, die mit den ersten Kontakten (25) elektrisch verbunden sind und dass die Dies (7) mit einer durch ein Vakuum erzeugten, vorgegebenen Kraft gegen die Elastomer-Bumps (6) gezogen werden.

20. 2. Carrier nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Kontakte (26) an der Spitze der Elastomer-Bumps (6) Goldkontakte sind.

25. 3. Carrier nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische Verbindung der ersten (25) mit den zweiten Kontakten (26) durch auf den Elastomer-Bumps (6) spiral- oder bogenförmig zur Spitze aufsteigende Leiterbahnen (27) hergestellt ist.

30. 4. Carrier nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die aufsteigenden Leiterbahnen (27) einen Kupfer-Nickel-Gold-Schichtaufbau aufweisen.

35. 5. Carrier nach Anspruch 2 und 4, dadurch gekenn-

zeichnet, dass zwischen dem Die (7) und dem Carrier ein Gold-Gold-Kontakt realisiert ist, indem auf dem Die (7) Re-Distribution-Layer angeordnet sind und die Re-Distribution-Layer (29) einen Kupfer-Nickel-Gold-Schichtaufbau aufweisen.

5

6. Carrier nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Die (7) bis zur endgültigen Montage im Carrier fixiert wird.

10 7. Carrier nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Fixierung des Dies (7) durch einen Deckel (4) erfolgt, der die Elastomer-Bumps (6) nach der Montage mit einer vorgegebenen Andruckkraft zusammendrückt.

15 8. Carrier nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Andruckkraft bei ungefähr 2 bis 8 Gramm pro Elastomer-Bump (6) liegt.

20 9. Carrier nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (4) als Federelement ausgebildet ist.

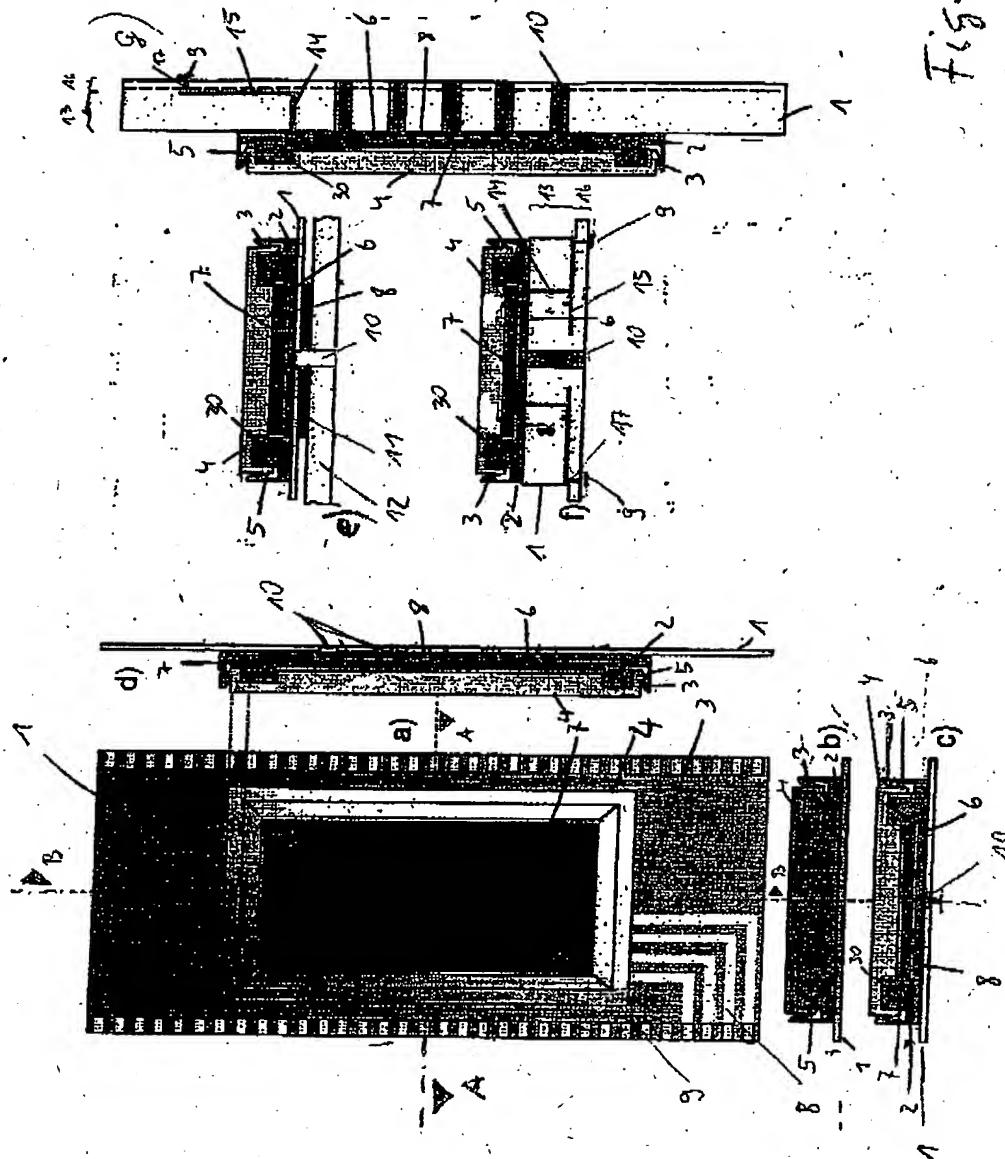
5 Carrier zur Aufnahme und zur elektrischen Kontaktierung von
vereinzelten Dies

Zusammenfassung

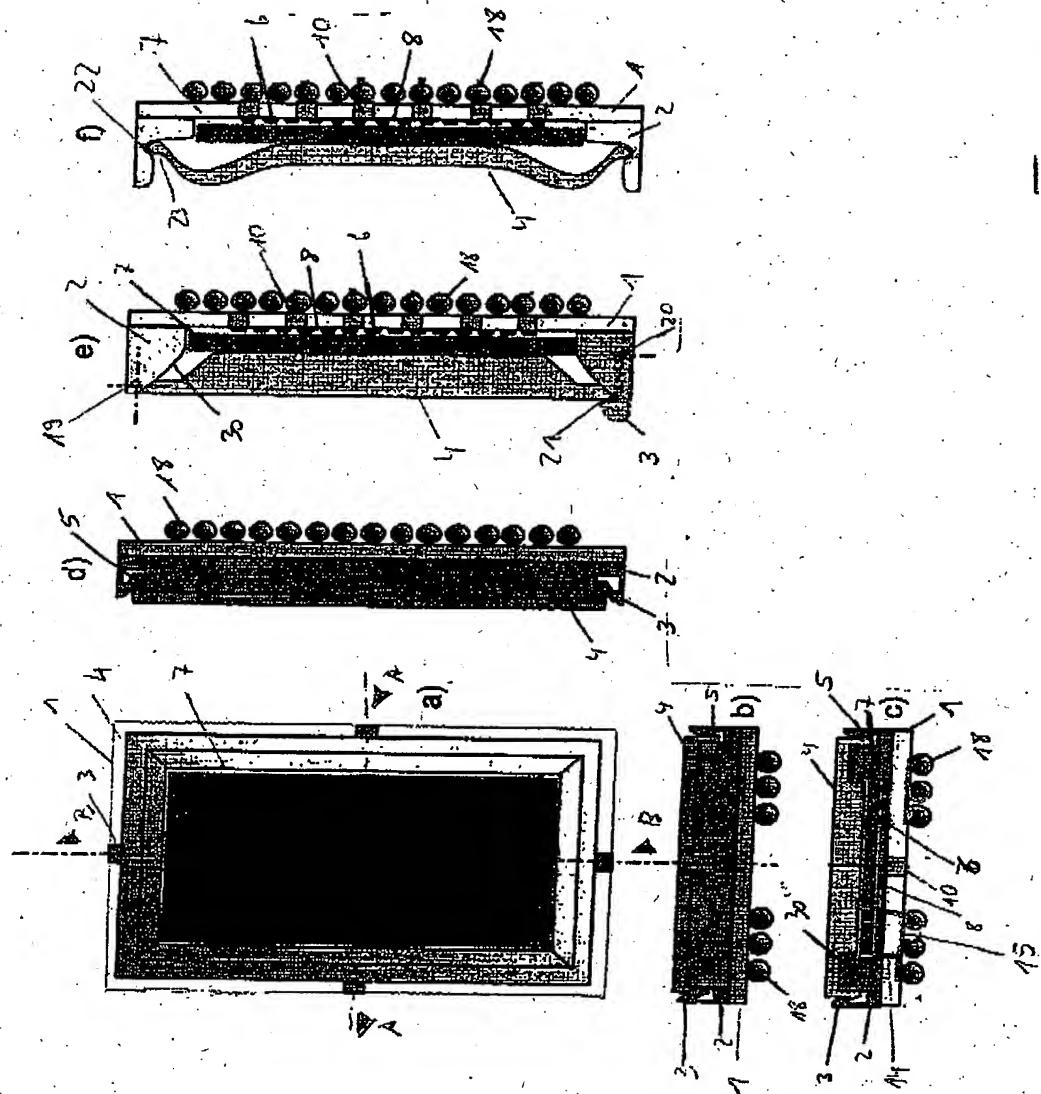
10 Der Erfindung, die ein Carrier zur Aufnahme und elektrischen Kontaktierung von vereinzelten Dies (Nacktchip) zum Testen und/oder zum BurnIn derselben dient, wobei der Carrier erste Kontakte aufweist, die in einem dem zu kontaktierenden Die entsprechenden Raster angeordnet sind, liegt die Aufgabe zugrunde, einen Carrier anzugeben, mit dem vereinzelte Dies genau mechanisch und elektrisch kontaktierbar sind, um deren Funktionsprüfung und Voralterung mit dem vorhandenen Equipment insbesondere zur Realisierung des „Known-Good-Die-Konzepts“ durchführen zu können. Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass die ersten Kontakte mit Elastomer-Bumps versehen sind, welche zweite Kontakte auf der Spitze aufweisen, die mit den ersten Kontakten elektrisch verbunden sind und dass die Dies mit einer durch ein Vakuum erzeugten, vorgegebenen Kraft gegen die Elastomer-Bumps gezogen werden. (Fig. 2 c)

19.

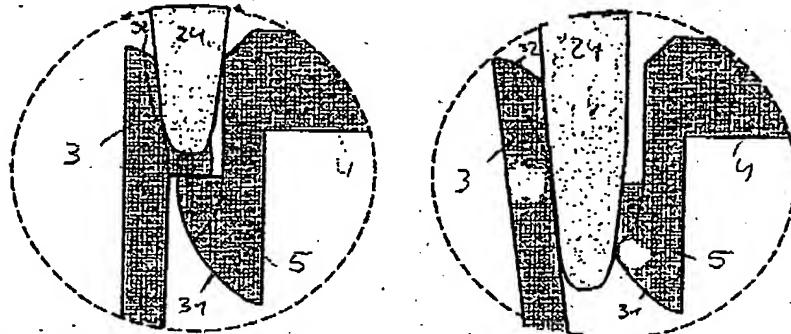
BEST AVAILABLE COPY



BEST AVAILABLE COPY



28



a)

6)

Fig. 3

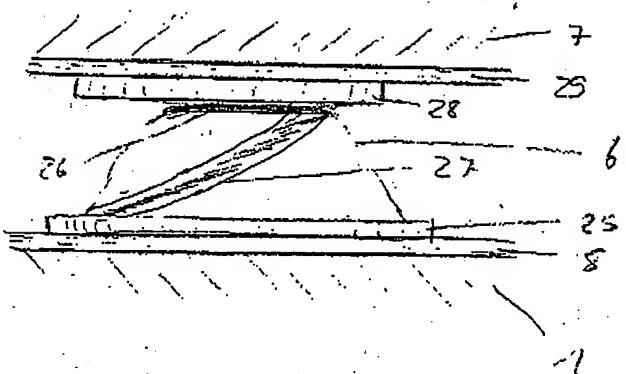


Fig. 4